

Antwort

der Bundesregierung

**auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Andrej Hunko, Christian Leye, Ralph Lenkert, Alexander Ulrich und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 20/6553 –**

Aktuelle Situation und Zukunft der Halbleiterindustrie in Deutschland und Europa

Vorbemerkung der Fragesteller

In den vergangenen Jahrzehnten ist die Fertigung von Halbleitern mitsamt den nachgelagerten Produktionsschritten aus den USA und Europa zunehmend nach Ostasien abgewandert. Europas Fertigungsanteil in der Halbleiterindustrie liegt heute bei unter 10 Prozent (vgl. „Der Chipbranche in Deutschland fehlen 62 000 Fachkräfte“ in FAZ am 3. März 2023, S. 26). Aufgrund knapper Produktionskapazitäten und gestörter Lieferketten kam es in den letzten Jahren zu massiven Engpässen bei der Versorgung mit Mikrochips. Allein die deutsche Industrie beziffert ihre Verluste daraus auf 1,6 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung, so der Bundesverband der Deutschen Industrie in einer Stellungnahme zusammen mit seinen französischen Partnerorganisationen (siehe dazu „Making the EU Chips Act deliver for French and German industry“ am 23. Mai 2022, S. 2). Zugleich verschärft die wachsende geopolitische Rivalität zwischen den USA und China die Risiken für eine stabile Versorgung mit diesen Bauteilen. Denn in diesem Konflikt geht es unter anderem um die Dominanz bei den Zukunftstechnologien und den Halbleitern. Die immer schärferen US-Sanktionen gegen Chinas Aufholjagd in der Halbleiterindustrie könnten nach Ansicht der Fragestellerinnen und Fragesteller längerfristig zu einer Aufspaltung der globalen Lieferketten führen – in einerseits um China zentrierte und andererseits um die USA zentrierte Lieferketten.

Das Ergebnis dieser komplexen Gemengelage aus Versorgungsengpässen, weiter steigender Nachfrage nach Chips und dem geopolitischen Großkonflikt ist ein Investitionsboom im Halbleitersektor: 2020 und 2021 wurden weltweit 34 neue Chipfabriken eröffnet, weitere 58 Werke gehen bis 2024 in Produktion. Dadurch würden sich die weltweiten Produktionskapazitäten um etwa 40 Prozent erhöhen (vgl. „When the chips are way down; After a turbocharged boom, are chipmakers in for a supersized bust?“ am 10. Juli 2022 in The Economist). Viele weitere Chipfabriken sind derzeit in Planung, auch wenn aufgrund aktueller Überkapazitäten manche Projekte verschoben werden.

Der US-amerikanische Kongress subventioniert mit dem CHIPS and Science Act von 2022 mit 280 Mrd. US-Dollar (www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/the-chips-and-science-act-heres-whats-in-it) die Entwicklung und Fertigung von Halbleitern in den USA. Die Förderung ist unter anderem an die Auflage gebunden, dass begünstigte Unternehmen – das

gilt auch für Unternehmen aus Europa – zehn Jahre lang keine modernen Chipfertigungen in China bauen dürfen (www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-117publ167/pdf/PLAW-117publ167.pdf sowie www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/09/fact-sheet-chips-and-science-act-will-lower-costs-create-jobs-strengthen-supply-chains-and-counter-china/).

Das vor der Verabschiedung stehende Europäische Chip-Gesetz (European Chip Act) soll bis 2030 Mittel in Höhe von 43 Mrd. Euro mobilisieren und damit den Anteil der EU an der globalen Chipfertigung von derzeit weniger als 10 Prozent auf 20 Prozent im Jahr 2030 steigern (siehe „Zwischen den Fronten“ in DER SPIEGEL am 11. März 2023). Dafür müssten sich aber nach Einschätzung der Fragestellerinnen und Fragesteller die Kapazitäten in der EU vervierfachen, weil sich die globale Produktion von Chips im gleichen Zeitraum verdoppeln wird. Derzeit ist unter den zehn größten Halbleiterproduzenten kein einziges Unternehmen aus Europa vertreten.

In Europa gibt es bislang kaum Fertigungen, die Chips mit einer Strukturgröße von kleiner als 22 nm produzieren können („Fabs with benefits“, *The Economist*, 12. Februar 2022, S. 56). Zwei Drittel der Mittel aus dem European Chip Act sollen deshalb in sogenannte Megafabs fließen. Das sind modernste, auf ultrafeine Chipstrukturen spezialisierte Werke, die pro Werk zwischen 10 Mrd. und 20 Mrd. Euro kosten. Bislang können nur die Unternehmen Intel, Samsung und TSMC diese Fertigungen bauen und betreiben. Der Rest der EU-Mittel ist für andere Werke zur Chipfabrikation vorgesehen.

Die Schwerpunkte des geplanten europäischen Förderungsprogramms für die Chipindustrie stehen in der Kritik. So hat beispielsweise ein Experte der Stiftung Neue Verantwortung bemerkt, dass der einseitige Fokus der EU auf allein die Chipfertigung falsch sei, denn nicht die Chipfertigung, sondern das Chipdesign der Teil der Chipindustrie mit der höchsten Wertschöpfung sei. Hier dominieren bislang US-amerikanische und taiwanesishe Firmen (siehe dazu und zu weiteren Kritikpunkten „Chipmaking champion?“ in *Financial Times* am 22. Juli 2021, S. 15).

Nach Ansicht der Fragestellerinnen und Fragesteller braucht es auch in der EU eine aktivere Industriepolitik, um die Chipfertigung vor Ort zu unterstützen. Allerdings sind die im European Chip Act vorgeschlagenen Schwerpunkte falsch gewichtet: Zwar hat die EU in der Chipindustrie allgemein und auch in der Chipfertigung Nachholbedarf, jedoch ist es nicht erkennbar, wie mit diesem engen Fokus auf die Fertigung von ultrafeinen Logik-Chips die technologische Zukunftsfähigkeit des Industriestandortes Europa verbessert werden kann. Zudem muss nach Ansicht der Fragestellerinnen und Fragesteller ein Subventionswettbewerb mit den USA und ostasiatischen Staaten, der in erster Linie Großkonzernen nützt, vermieden werden und staatliche Förderungen an Bedingungen für gute Arbeit und Mitarbeiterbeteiligung geknüpft werden.

1. Wie betrachtet die Bundesregierung die generelle Zielsetzung und die Schwerpunkte des European Chip Act?

Die Bundesregierung teilt die Ziele des European Chips Act, die Produktion fortschrittlicher und nachhaltiger Mikrochips in Europa bis 2030 steigern zu wollen, Abhängigkeiten zu reduzieren, die Resilienz des Halbleiterökosystems in der Europäischen Union (EU) zu stärken und den digitalen und ökologischen Wandel voranzubringen.

Aus Sicht der Bundesregierung adressiert der European Chips Act zentrale Bereiche der Halbleiterwertschöpfungskette. Im Fokus des European Chips Act stehen eine Stärkung der Design-, Forschungs- und Entwicklungskapazitäten für fortschrittliche Halbleiter- sowie Quantentechnologien, die Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), Start-ups und Scale-ups, die Fachkräfteförderung, ein investitionsfreundlicher Rahmen zur Errichtung neu-

artiger Fertigungsanlagen zur Halbleiterproduktion sowie Instrumente zur Früherkennung von Halbleiterengpässen und -krisen.

Die Bundesregierung begrüßt diesen umfassenden Ansatz und sieht in dem European Chips Act ein wichtiges Instrument, um weitere Investitionen in Halbleitertechnologien in der Europäischen Union zu ermöglichen und das Halbleiterökosystem in der Europäischen Union umfassend zu stärken.

2. Unterstützt die Bundesregierung den European Chip Act, und falls ja,

Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen.

- a) welche Ziele verfolgt sie damit, und

Der European Chips Act setzt einen geeigneten Rahmen für Maßnahmen der Bundesregierung, die die Stärkung des Halbleiterökosystems in Deutschland und der Europäischen Union entlang der gesamten Wertschöpfungskette, den Ausbau von Kapazitäten für Design, Forschung, Entwicklung und Produktion von Halbleitertechnologien und -anwendungen sowie Quantentechnologien zum Ziel haben. Entsprechende Maßnahmen werden unter anderem im Rahmenprogramm der Bundesregierung „Mikroelektronik. Vertrauenswürdig und nachhaltig. Für Deutschland und Europa.“ adressiert.

Die Bundesregierung hat sich darauf verständigt, Ansiedlungs- und Ausbauprojekten von Halbleiterherstellern in Deutschland zu unterstützen und hat dafür Mittel im Bundeshaushalt 2023 bereitgestellt. Aus Sicht der Bundesregierung setzt der European Chips Act einen investitionsfreundlichen und bedarfsorientierten Rahmen für Investitionen in Halbleitertechnologien und „Chips made in Europe“. Insgesamt ist damit die Förderung von innovativen und nachhaltigen Halbleitertechnologien möglich, die Schlüssel für die digitale und grüne Transformation sind.

- b) welche konkreten Maßnahmen plant die Bundesregierung zur Umsetzung des European Chip Act in Deutschland?

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) realisiert in den Bereichen Mikroelektronik und Kommunikationstechnologien aktuell ein weiteres, zweites Important Project of Common European Interest (IPCEI) vorbehaltlich der beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission. Dieses steht unter dem Motto „Safety, Security, Sustainability and Sovereignty“ und hat das Ziel, bei Mikroelektronik und Kommunikationstechnologien vor allem dort aufzuholen, wo Europa zum Teil technologisch abhängig von Drittstaaten ist, beispielsweise bei Hochleistungsprozessoren und Spezialchips für die Künstliche Intelligenz (KI) und autonomes Fahren.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) stellt im oben genannten Rahmenprogramm der Bundesregierung die erforderliche nationale Kofinanzierung für die europäische Partnerschaft „Key Digital Technologies Joint Undertaking“ (KDT JU) bereit. Das KDT JU soll durch den European Chips Act unter dem neuen Namen „Chips Joint Undertaking“ (Chips JU) fortgeführt werden. Das Chips JU soll den Aufbau technologischer Kapazitäten sowie Forschungs- und Innovationstätigkeiten unterstützen, um die Entwicklung und den Einsatz von Halbleiter- und Quantentechnologien der neuesten und der nächsten Generation sowie die Innovation etablierter Technologien zu ermöglichen. Die Vorbereitungen zur Umsetzung laufen derzeit unter Beteiligung des BMBF auf europäischer Ebene.

Die Bundesregierung beabsichtigt ferner, bedeutsame und strategisch wichtige Ansiedlungs- und Ausbauprojekte für die Herstellung von Halbleiterchips im Rahmen des European Chips Act zu unterstützen.

3. Hält die Bundesregierung das von der EU formulierte Ziel für realistisch, dass diese bis 2030 einen Anteil von 20 Prozent an der weltweiten Chipfertigung erreicht, und wenn ja, welche Maßnahmen plant die Bundesregierung zu ergreifen, um dieses Ziel zu verfolgen?

Die Bundesregierung ist bereit, das Ziel der Europäischen Kommission zu unterstützen, den Anteil Europas Produktionskapazitäten für Halbleiterchips bis 2030 steigern zu wollen. Zu den Maßnahmen wird auf die Antwort zu Frage 2b verwiesen. Das Ziel einer Verdoppelung des europäischen Anteils an der Weltproduktion ist ambitioniert. Kernziel ist die Sicherung der technologischen Spitzenrolle der Europäischen Union sowie die Gewährleistung einer sicheren Versorgung mit Halbleiterchips.

4. Begrüßt die Bundesregierung das Ziel, auch Chipfertigungen für ultrafeine Chips in Deutschland und in der EU anzusiedeln?

Die Bundesregierung begrüßt auch den Aufbau von Fertigungskapazitäten auf kleinen Strukturgrößen (Technologieknoten kleiner bzw. gleich 10 Nanometer). Diese stellen eine wichtige Grundlage für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland und der Europäischen Union unter anderem in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Autonomes Fahren dar.

5. Teilt die Bundesregierung die Einschätzung der Fragesteller, dass in der EU selbst eine zu geringe Nachfrage nach den in den neuen Werken produzierten Chips besteht?

Die Bundesregierung teilt diese Einschätzung nicht. Insgesamt wird innerhalb des nächsten Jahrzehnts mit einer Unterversorgung gerechnet. Die Voraussetzungen für die Versorgungssicherheit werden aber bereits jetzt geschaffen und werden daher proaktiv gefördert. Die Bundesregierung begrüßt jedes ernsthafte Interesse von Unternehmen, basierend auf einer internen Geschäftsrisikoanalyse am Standort Deutschland zu investieren und ist bereit, eine Unterstützung zu prüfen. Jeder Förderung einer neuen Chipfabrik oder eines Kapazitätsausbaus geht daher stets eine eingehende Bewertung des prognostizierten Bedarfs nach der zu fördernden Technologie voraus. Die zukünftigen deutschen und europäischen Chipbedarfe sind dabei hinsichtlich ihrer Technologieknotengröße differenziert zu betrachten.

6. Sieht die Bundesregierung eine Gefahr von Mitnahmeeffekten bei der Umsetzung des European Chip Act, und falls ja, wie will sie die Mitnahmeeffekte verhindern bzw. vermeiden?

Die Vermeidung von Mitnahmeeffekten wird durch die auch unter dem European Chips Act geltenden strengen beihilferechtlichen Bestimmungen wie etwa das hohe Innovationsniveau („first-of-a-kind“) sowie durch das nationale Zuwendungsrecht gewährleistet.

7. Teilt die Bundesregierung die Position (siehe die Vorbemerkung der Fragestellerinnen und Fragesteller), dass die europäische Industrie eher andere Halbleiterprodukte als jene mit den kleinsten Strukturgrößen braucht und dass es deswegen effizienter wäre, bereits bestehende Strukturen der Halbleiterindustrie weiterzuentwickeln?

Die Bundesregierung ist sich der Bedarfe der deutschen und europäischen Industrie bewusst. Ihr ist insbesondere auch bewusst, dass sich der Innovationscharakter nicht allein auf die Strukturgröße der Halbleiterchips begrenzt. Deshalb hat die Bundesregierung – etwa bei der Schwerpunktsetzung für die Förderung von Ansiedlungen – nicht nur Fertigungskapazitäten von Halbleiterchips auf kleinsten Strukturgrößen im Blick. Sie hat sich im Gesetzgebungsverfahren zum European Chips Act zudem für eine Ausrichtung der Forschungs- und Innovationsaktivitäten wie auch des Investitionsrahmens für Halbleiterproduktionsanlagen eingesetzt, welche sowohl eine zukünftige Nachfrage nach kleinen Strukturgrößen als auch die gegenwärtigen Bedarfe der Anwenderindustrien berücksichtigt. Die unter dem European Chips Act geförderten Projekte müssen einen signifikanten Beitrag zur Versorgungssicherheit Deutschlands und Europas leisten, einen positiven Effekt auf das Halbleiterökosystem der Europäischen Union insgesamt haben und einen Innovationscharakter aufweisen, der über den Stand der Technik in Europa hinausgeht („first-of-a-kind in Europe“). Unterstützt werden können Investitionen in Halbleiterfertigungen für innovative Halbleiterchips oder für ausgereifte Technologieknoten, wenn das Vorhaben signifikant zu anderen europäischen Zielen beiträgt, wie zum Beispiel dem Green Deal und der europäischen Technologiesouveränität.

8. Begrüßt die Bundesregierung die Subventionen für die Ansiedlung der Intel-Fertigung in Deutschland, und wenn ja, mit welcher Begründung?

Die Bundesregierung begrüßt und unterstützt das Investitionsinteresse der Intel Deutschland GmbH in Magdeburg. Aus Sicht der Bundesregierung würde eine entsprechende Investition aufgrund der globalen Ausrichtung des Vorhabens einen bedeutsamen Impuls für die Weiterentwicklung des Halbleiterökosystems in Deutschland und der Europäischen Union setzen und wichtige Innovationspotenziale eröffnen. Der Chiphersteller Intel Deutschland GmbH ist in der Lage, kleinste Knotengrößen in großem Produktionsumfang herzustellen, die bisher in Deutschland und der Europäischen Union nicht vorhanden sind.

9. Existieren nach Kenntnis der Bundesregierung Kosten-Nutzen-Analysen über den Einsatz öffentlicher Mittel für das geplante Intel-Werk in Magdeburg, und wenn ja, welche (bitte angeben)?

Vor der Förderung wird im Rahmen der zuwendungsrechtlichen Prüfung eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erstellt, die unter anderem Kosten und Nutzen eines Projektes für Deutschland bewertet.

10. Existieren nach Kenntnis der Bunderegierung Kalkulationen über die direkte und indirekte Arbeitsplatzbilanz des geplanten Intel-Werkes in Magdeburg, und wenn ja, welche?

Das Unternehmen plant nach eigenen Angaben die Schaffung von 3 000 Arbeitsplätzen für sein Werk in Magdeburg. Zusätzlich sollen während der Bau-phase bis zu 7 000 Arbeitnehmende bei dem Bau des Standorts beschäftigt sein (www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/eu-news-2022-release.html). Zudem ist bekannt, dass die Halbleiterindustrie einen Multiplikatoreff-

fekt auf die Anzahl an Arbeitsplätzen im Umfeld aufweist. Für jeden geschaffenen Arbeitsplatz in der Halbleiterfertigung entstehen durchschnittlich mehr als fünf weitere Arbeitsplätze.

11. Wird Intel nach Kenntnis der Bundesregierung auch das Chipdesign (den Teil der Halbleiterproduktionskette mit der höchsten Wertschöpfung) in Magdeburg ansiedeln, und sieht die Bundesregierung einen Weg, Intel dazu zu bewegen?

Die Intel Deutschland GmbH plant mit ihrer Ansiedlung in Magdeburg, ihre Fertigungskapazitäten auch für Dritte zu öffnen („Foundry-Konzept“). Auf diesem Weg würde deutschen und europäischen Unternehmen die Möglichkeit gewährt, entworfene Chipdesigns in Magdeburg zu produzieren. In diesem Zusammenhang plant die Intel Deutschland GmbH die Eröffnung eines Chipdesignzentrums in Frankreich, welches für Designaktivitäten und Halbleiter-Forschung und Entwicklung deutscher und europäischer Unternehmen offensteht (siehe www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/eu-news-2022-release.html). Eine Ansiedlung eines Zentrums für Chipdesign in Magdeburg ist derzeit nicht vorgesehen. Im Zuge von Kooperationen von deutschen Forschungseinrichtungen mit der Intel Deutschland GmbH und der Öffnung der Produktion für Dritte ist von einem positiven Effekt auf die Chipdesign-Kompetenzen innerhalb Deutschlands auszugehen (siehe www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/eu-news-2022-release.html). Dieser Effekt wird durch begleitende Maßnahmen der Bundesregierung zur Stärkung des Innovationsökosystems im Chip-Design unterstützt.

12. Ist Intel in Magdeburg nach Kenntnis der Bundesregierung besser vor Lieferengpässen bei Vorprodukten geschützt als Intel in den USA?

Grundsätzlich sind die komplexen Lieferketten in der Halbleiterindustrie global organisiert. Eine geographische Diversifikation der Produktion bedeutet in der Regel auch eine Diversifikation der Lieferketten.

Zu den Bedingungen des Unternehmens in den USA sind keine Angaben bekannt.

13. Strebt die Bundesregierung den Aufbau eines kompletten Ökosystems für die Halbleiterentwicklung und Halbleiterfertigung in Deutschland bzw. innerhalb der EU analog zu dem Ökosystem in Ostasien an?

Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, das Halbleiterökosystem in Deutschland und Europa entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiter zu stärken und Lieferketten zu diversifizieren, um Abhängigkeiten zu reduzieren, die Resilienz zu stärken und die künftige Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Dabei werden Stärken und Schwächen entlang der Halbleiterwertschöpfungskette adressiert.

14. Sollen aus der Sicht der Bundesregierung künftig auch die nachgelagerten Produktionsschritte wie Chip-Packaging und Chip-Testing im EU-Raum stattfinden, und falls ja, wie kann das nach Ansicht der Bundesregierung angesichts des Sachverhalts, dass die entsprechenden arbeitsintensiven Produktionsschritte weitgehend aus Gründen der Profitmaximierung an Niedriglohnstandorte in Asien verlagert wurden, erreicht werden?

Aus Sicht der Bundesregierung kann nur durch Diversifizierung und Abbau der einseitigen Abhängigkeit von einzelnen geographischen Regionen die Versorgungssicherheit Deutschlands und Europas gewährleistet werden. Deshalb sollten aus Sicht der Bundesregierung – wo in Hinblick auf Innovationsgehalt und Nachhaltigkeit möglich und geboten – auch nachgelagerte Produktionsschritte in Europa gestärkt bzw. wiederangesiedelt werden, zum Beispiel das sogenannte „Advanced Packaging and Testing“.

15. Will die Bundesregierung mittelfristig die Abwanderung der Halbleiterindustrie in die USA angesichts der Tatsache, dass die Subventionen für die Chipindustrie dort weitaus höher sind, vermeiden, und wenn ja, mit welchen Mitteln, und erwägt die Bundesregierung dabei, einen Subventionswettbewerb mit den USA anzutreten?

Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, einen Subventionswettbewerb mit anderen Regionen, die staatliche Beihilfeprogramme für Halbleitertechnologien vorsehen, zu verhindern, da dies für keine Region der geeignete Weg ist, Wettbewerb und Innovation zu verbessern. In dieser Hinsicht bekräftigt die Bundesregierung zum einen die Notwendigkeit, auch zum Beispiel im Rahmen des European Chips Act die Kriterien des europäischen Wettbewerbsrechts zur Geltung zu bringen. Zum anderen strebt die Bundesregierung aktiv den Austausch und Kooperationen mit anderen Staaten an, zum Beispiel im Rahmen des europäisch-amerikanischen Handels- und Technologierats.

Die Bundesregierung verfolgt gemeinsam mit der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten das Ziel, Investitionen in die Halbleitertechnologien in Europa anzureizen und zu ermöglichen. Deshalb unterstützt sie unter anderen den European Chips Act. Zu den geplanten Maßnahmen wird auf die Antwort zu Frage 2b verwiesen.

16. Welchen Einfluss haben nach Kenntnis der Bundesregierung der amerikanische CHIP and Science Act von 2022 und die verschärften US-Chip-Sanktionen gegen China auf die Geschäfte von Halbleiterkonzernen mit Sitz in Deutschland und in der EU?

Der Einfluss des (a) amerikanischen CHIP and Science Act sowie die (b) US-Chip-Sanktionen gegenüber China sind getrennt voneinander zu betrachten.

- a) Mit dem U.S. CHIPS and Science Act, der eine Förderung der Halbleiterbranche in den USA mit einem dreistelligen Milliardenbetrag bis 2030 vorsieht, verschärft sich die globale Konkurrenzsituation zwischen den Unternehmen. Ein Vergleich der amerikanischen Förderinitiative mit dem europäischen Pendant (European Chips Act) zeigt, dass die Ziele sowie die Förderbedingungen grundsätzlich gleich sind. Der U.S. CHIPS and Science Act weist gegenüber dem European Chips Act deutlich mehr Mittel auf. Allerdings spielen bei einer Standortentscheidung von Unternehmen auch andere Faktoren eine maßgebliche Rolle, etwa mögliche Bedingungen für investierende Unternehmen, die mit einer Förderung in den USA einhergehen.

b) Die genannten Maßnahmen können Auswirkungen für die deutschen und europäischen Halbleiterhersteller haben, wobei keine detaillierten Informationen zu einzelnen Unternehmen vorliegen.

17. Welchen Einfluss haben nach Kenntnis der Bundesregierung der US CHIP and Science Act 2022 und die neuen US-Chip-Sanktionen gegen China auf die Geschäfte der Zulieferer aus Deutschland und der EU auf dem Gebiet des Maschinenbaus?

Die genannten Maßnahmen haben Auswirkungen für die deutschen und europäischen Zulieferer aus dem Maschinen- und Anlagenbau, wobei keine detaillierten Informationen zu einzelnen Unternehmen vorliegen. Allgemein lässt sich festhalten, dass die Maschinenbauer in ihrer Rolle als Ausrüster von der erhöhten Nachfrage profitieren können, die der U.S. CHIPS and Science Act auslöst. Ebenfalls aus der Ausrüsterperspektive bemerkt die Branche derzeit verstärkte Verlagerungstendenzen in andere, zumeist südostasiatische Länder. Dies geschieht im Rahmen einer sogenannten China+1-Strategie, die darauf abzielt, Investitionen nur in China zu vermeiden und das Geschäft in andere Länder zu diversifizieren.

18. Welchen Einschränkungen unterliegen nach Kenntnis der Bundesregierung der Maschinenbauer ASML sowie seine Zulieferer wie Zeiss, Trumpf und Siemens EDA durch die gegen China gerichteten US-Sanktionen in der Halbleiterindustrie?

Die Frage nach den Einschränkungen bezieht sich auf Regelungen des US-amerikanischen Rechts bzw. faktische Auswirkungen dieser Regelungen, zu denen keine Informationen vorliegen.

19. Plant die Bundesregierung Maßnahmen zum Schutz deutscher Unternehmen vor Umsatzeinbrüchen aufgrund dieser US-Sanktionen (siehe Frage 18), und wenn ja, welche?

Die Bundesregierung ist mit der Industrie im Austausch. Wie immer sind die Unternehmen selber angehalten, ihre Lieferketten soweit zu diversifizieren, dass der Geschäftsbetrieb aufrecht erhalten bleiben kann.

20. Existieren nach Kenntnis der Bundesregierung Erwägungen auf der EU-Ebene, die Fertigungstechnologien für Chips im EU-Raum durch Förderung zu sichern und auszubauen?

Es wird auf den European Chips Act verwiesen. Weitere Vorhaben der Europäischen Kommission in diesem Bereich sind der Bundesregierung derzeit nicht bekannt.

21. Kann nach Ansicht der Bundesregierung auch eine Ansiedlung des chinesischen Staatskonzerns SMIC in Deutschland durch die EU oder mit Bundes- und Landesmitteln gefördert werden, und wenn nein, warum nicht?

Entsprechende Ansiedlungsvorhaben müssen die geltenden beihilfe- und zwendungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen, um für eine Förderung in Betracht zu kommen. Ferner muss ein entsprechendes Bundes- bzw. Landesinteresse vorhanden sein. Ob die Voraussetzungen vorliegen, wird in jedem Einzelfall eingehend geprüft.

